

# DW 5 PLUG

Part No. 20598-\*\*\*T-0\*

## Assembly Manual

2	S15631	Dec./17/ 2015	Y.F		Ted
1	S14237	Jun./17/2014	T.Y		Tom
0	S12483	Oct./26/2012	T.Yoshisuji		K.Narita
Rev.	ECN	Date	Prepared by	Checked by	Approved by

## 1.目的 (Purpose) :

DW 5 PLUG において、ケーブルの半田付け手順について明記する。

This manual is to explain the soldering method / process of the DW 5 PLUG with cable.

## 2.適用コネクタ (Applicable connector) :

Name : DW 5 PLUG

Parts No. : PLUG HOUSING ASS'Y : 20598-\*\*\*T-0\*

## 3.使用機器等 (Fixtures) :

- ・ パルスヒート (Pulse heater)
- ・ ヒーターチップ (Heater chip)

加圧力 (Pressure) : 9.8N (1.0kgf)

### 【Size】

Positions	幅 (Width) mm	板厚 (Thickness) mm
6P	3.4	0.6
10P	5.4	0.6
20P	10.4	0.6

- ・ 半田バー (Solder bar)

(推奨)  $\phi 0.12\text{mm}$  (単芯ヤニ入り半田) の糸半田を潰して使用

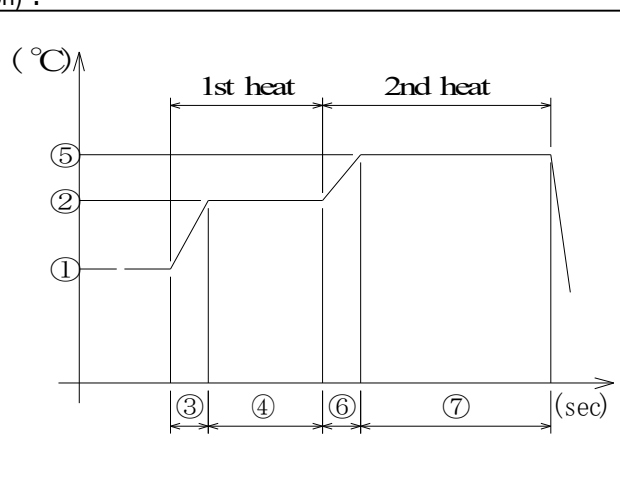
(Recommended)  $\phi 0.12\text{mm}$  (resin-cored solder) is pressed and used.

Positions	Length (mm)	Width (mm)	Thickness (mm)
6P	$3.0^{+0.2}$	$0.2^{+0.1}$	$0.05^{+0.02}$
10P	$5.0^{+0.2}$	$0.2^{+0.1}$	$0.05^{+0.02}$
20P	$10.0^{+0.2}$	$0.2^{+0.1}$	$0.05^{+0.02}$

- ・ 半田コテ (Soldering iron) 50W
- ・ UV 照射器 (UV irradiator)
- ・ 接着剤: LOCTITE 352 (UV 樹脂)      bond: LOCTITE 352 (UV glue)

## 4.パルスヒート条件 [推奨] (Recommended pulse heat condition) :

①アイドリング温度 (Idle temp.)	150°C
②1stヒート設定温度 (1st heat temp.)	220°C
③ " 立ち上がり時間 ( " rise time)	0.5sec.
④ " 維持時間 ( " holding time)	3.0sec.
⑤2ndヒート設定温度 (2nd heat temp.)	305°C
⑥ " 立ち上がり時間 ( " rise time)	0.5sec.
⑦ " 維持時間 ( " holding time)	3.0sec.



## 5.作業手順 (Work procedures) :

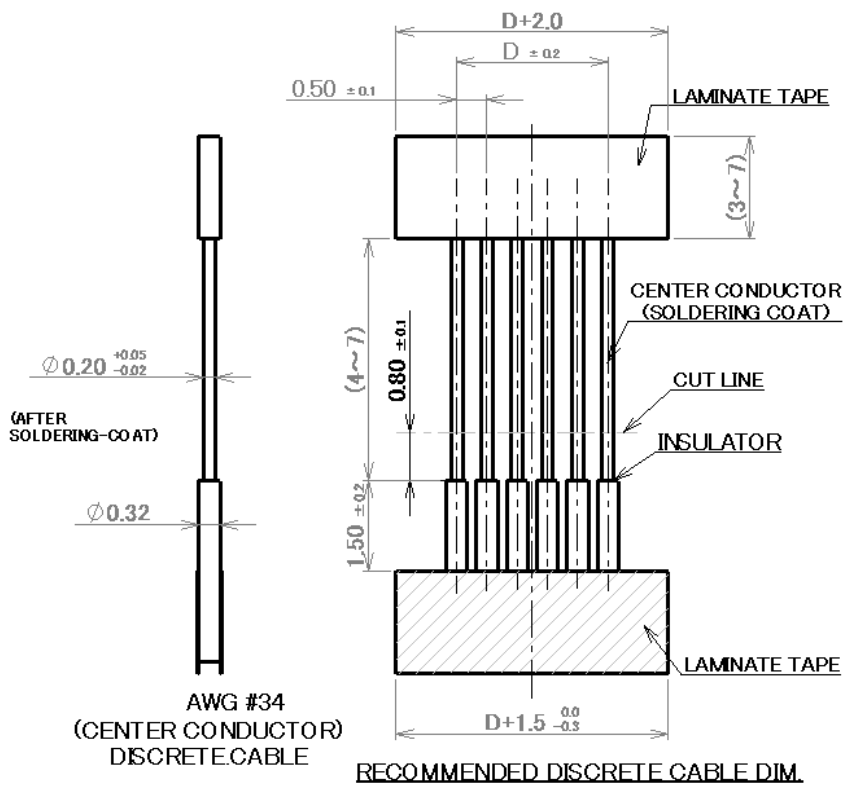
### 5-1. 芯線の半田付け (Soldering of center-conductor)

① 適合ケーブルの端末処理形状を下図の様にして下さい。

The cables have to be fabricated as shown below in advance of soldering.

(mm)

PART No.	POS.	D
20598-006T-0*	6	2.5
20598-010T-0*	10	4.5
20598-020T-0*	20	9.5



②コネクタに半田バーをセットする。

Pre-set and locate solder bar at center of connector (HSG ASS'Y).

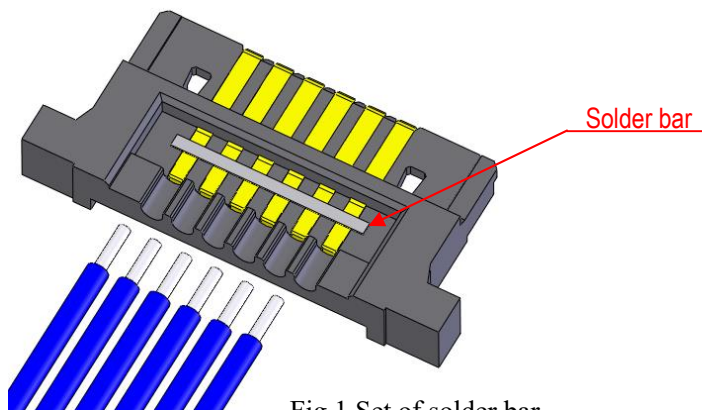


Fig.1 Set of solder bar

## ③ケーブルをセットする。 (Fig2)

Set the cable.

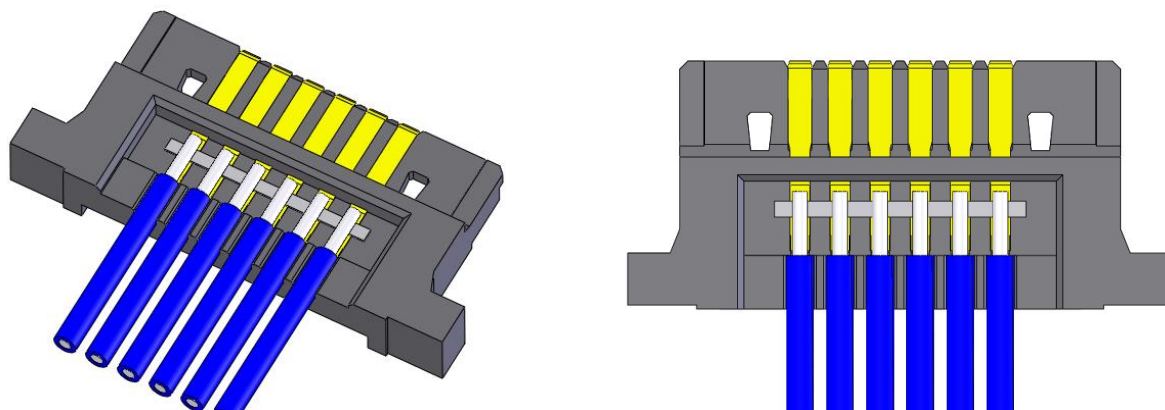


Fig.2 Set of cable

## ④芯線をパルスヒートにて半田付けする。半田付け状態は、下記 Photo.1 参照。

嵌合側への半田シジダしは 0.15mm MAX.にて管理願います。(Photo.1 参照)

推奨半田バー (φ0.12mm の糸半田を潰して使用 : 2 頁参照) を使用した場合、半田シジダしは発生しません。

Center-conductors are soldered with pulse heater. See photo.1 of soldering condition.

Wicking to the mating side is 0.15mm MAX.. (See photo.1.)

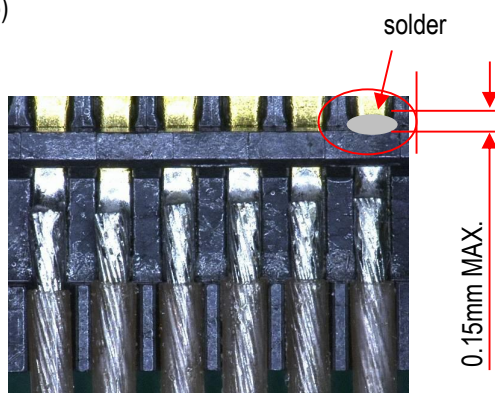
When you use recommended solder bar,  
solder wicking isn't appeared. (See sheet 2 of 5)

Photo.1 CenterConductor

※万が一、極間が短絡した場合は、再度パルスヒートにて加熱を行って下さい。

製品にダメージを与える恐れがある為、回数は 1 回だけです。

これで短絡が直らない場合は、NG 箇所のみ半田コテにて手修正して下さい。

※When solder bridge is appeared between the terminal, try heating again with pulse heater only one time.

If the bridge isn't repaired, use the soldering iron only a NG point.

半田コテの条件 (Condition of Soldering iron) : 50W

半田コテ先温度 (Operating temperature) : 350℃

コテ先当て時間 (Application time of soldering iron) : 5 秒以内 (Within 5sec.)

## 5-2. ケーブル固定 (Fixation of the cable)

ケーブル端末部を接着剤にて固定する。

推奨接着剤 : LOCTITE 352

The cable terminal part is fixed with the bond.

Recommended bond: LOCTITE 352

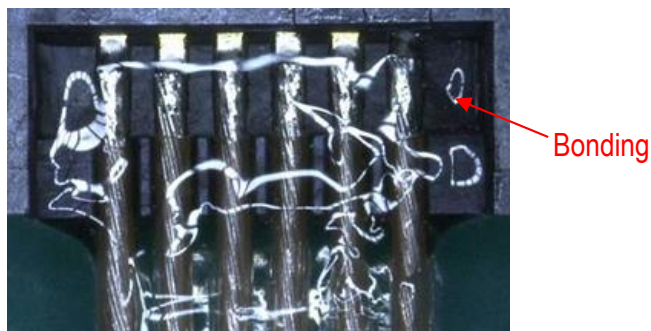
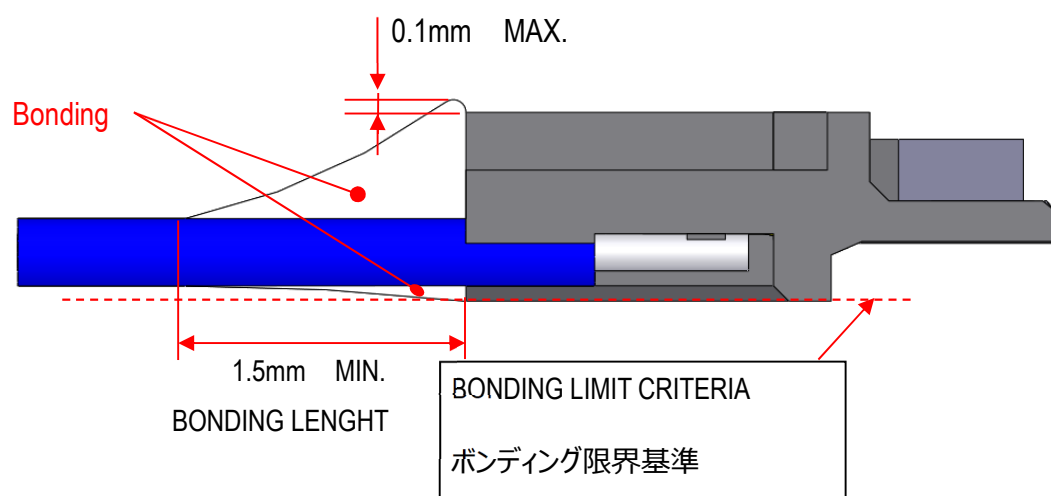


Photo.2 Bonding



BONDING SHALL NOT EXCEED THE LIMIT CRITERIA.

ボンディングは限界基準を超えないで下さい。

Fig.3 Bonding